**周总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **周几** | **实验内容（要具体）** | **备注（存的问题，文献，想法）** |
| 7.16 | 一 | 1、转移二维材料到蒸好金的芯片上，共转移两片。 | 两片用不同的转移方式，主要区别在于PMMA覆盖方式：匀胶机旋涂（1000rpm）和直接滴到基片上。结果表面两者结果相差不大，而直接滴到基片上操作更简单，且对材料保护更好。 |
| 7.17 | 二 | 1、SEM看硅上金颗粒形貌。  2、退火硅上金颗粒（300℃，1h） |  |
| 7.18 | 三 | 1、Lumerical培训  2、SEM看退火后金颗粒形貌。（平面和截面） | SEM可以看到特殊的结构形状，一个大的金颗粒（60nm）周围分布有一圈小的金颗粒（5nm左右）。 |
| 7.19 | 四 | 1、PDMS翻模、固化和切割。  2、组会和组会PPT。 |  |
| 7.20 | 五 | 1、PDMS键合，通液测试。  2、整理实验室。 |  |

本周工作：1、转移二维材料。2、看SEM两次。3、金颗粒退火。4、PDMS微流通道翻模、固化和键合，5、芯片通液实验。

下周计划：做完目前实验，放假回家。